平成21年3月期 第1四半期決算短信

平成20年8月6日

上場会社名　日本インター株式会社　　上場取引所　東
コード番号　6974　URL　http://www.niec.co.jp
代表者　（役職名）代表取締役社長　（氏名）石井 政夫
問合せ先責任者　（役職名）経理部長　（氏名）福山 史彦　TEL　0463-84-8015
四半期報告書提出予定日　平成20年8月12日

（百万円未満切捨て）

1. 平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日）

(1) 連結経営成績（累計）

（%表示は対前年同四半期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
21年3月期第1四半期	9,305	—	△404	—	△407	—	△242	—
20年3月期第1四半期	9,103	0.3	313	△42.9	221	△51.5	121	△56.8

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
21年3月期第1四半期	△7.85	—
20年3月期第1四半期	3.91	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
21年3月期第1四半期	38,557	9,793	25.4	316.39
20年3月期	37,247	9,879	26.5	319.16

（参考）自己資本　21年3月期第1四半期　9,793百万円　20年3月期　9,879百万円

2. 配当の状況

	1株当たり配当金				
（基準日）	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	年間
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
20年3月期	—	4.00	—	2.00	6.00
21年3月期	—	―――	―――	―――	―――
21年3月期（予想）	―――	—	—	4.00	4.00

（注）配当予想の当四半期における修正の有無　無

3. 平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

（%表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期連結累計期間	19,700	—	250	—	50	—	0	—	0.00
通期	41,000	6.5	1,000	187.5	600	—	200	—	6.46

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無　無

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無
　新規　— 社（社名　　）　除外　— 社（社名　　）

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用　有
　（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧下さい。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの）
　① 会計基準等の改正に伴う変更　有
　② ①以外の変更　無
　（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧下さい。

(4) 発行済株式数（普通株式）
　① 期末発行済株式数（自己株式を含む）　21年3月期第1四半期　31,577,550株　20年3月期　31,577,550株
　② 期末自己株式数　21年3月期第1四半期　623,757株　20年3月期　623,799株
　③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間）　21年3月期第1四半期　30,953,793株　20年3月期第1四半期　30,941,484株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　業績予想につきましては、現時点で把握可能な情報に基づき、合理的と判断した前提により作成しておりますが、多彩なリスクや不確定な要因を含んでおり、実際の業績等は、記載の内容と異なる可能性があることをあらかじめご承知おき下さい。
　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

【定性的情報・財務諸表等】

1.　連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期の連結業績は、売上高が前年同期比2.2%増の93億5百万円となりました。うち、製品は前年同期比8.6%減の47億91百万円、商品は前年同期比16.9%増の45億14百万円となりました。

民生向けの半導体素子製品は、夏のオリンピックを控え、春先からの需要が期待されたほど立ち上がらず、加えて前年に比べ原油高やサブプライムローン問題による米国経済の後退、円高の影響もあり、前年同期比8%減の32億60百万円となりました。高周波用整流素子のSBD（ショットキー・バリア・ダイオード）は、前期より進めて参りました台湾・中華地区の販売強化により、ODMメーカーへの採用で液晶テレビ向けが好調な伸びを示しました。また今期大幅な伸びを見込んでいる太陽電池モジュール向けの新製品薄型パッケージも計画どおり順調に推移しました。しかしながらパソコン関連や遊技機向けなどが低迷したことで、前年同期比では減少となりました。超高速整流素子のFRED（ファースト・リカバリー・エピタキシャル・ダイオード）は、ハイブリッド車市場の拡大から車載向けが好調に推移しました。この他インバータなど産業機器向けも前年同期比二桁の伸びを示し、主力とするプラズマテレビ向けの減少を吸収しました。

産業向けの半導体応用製品は、前年同期比9%減の15億31百万円となりました。主力とする汎用インバータや工作機向けが伸びたことに加え、市場が拡大しているバッテリーフォークリフト向けも好調で、産業機器市場向けは前年同期比6%増となりました。しかしながら生産調整による携帯基地局電源用ユニットの減少などが影響し、半導体応用製品全体では伸び悩みました。

商品は、前期に引き続きアミューズメント向けの引き合いが活発で、顧客のニーズに合せ、カスタム化したモジュールや電源など、開発商品と液晶が伸びたことで、前年同期を大きく上回りました。

損益面におきましては、原価低減と新製品の投入に努めたものの、製品売上の伸び悩みから、設備投資に伴う償却負担増を吸収することができず、加えて円高の影響に伴う棚卸資産の簿価切り下げを行ったことで製品粗利益が大きく落ち込み、営業損益は4億4百万円、経常損益は4億7百万円、四半期純損益は2億42百万円のいずれも損失となりました。

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

①日本

商品は前期に引き続きアミューズメント向けが堅調に推移したものの、民生市場向けを中心とした製品売上が伸長せず、売上高は73億7百万円（前年同期比3.2%減）となりました。また、多角的なコスト削減に努めたものの、製品売上減少、原材料費の高騰による粗利益の減少などで2億75百万円（前年同期比189.4%減）の営業損失となりました。

②アジア

アジアでは中国国内における産業機器市場向け製品の需要拡大が売上に寄与し、また香港における連結子会社の売上も順調に推移したことで、売上高は19億97百万円（前年同期比28.8%増）となりました。しかしながら損益面では、原材料費・販売管理費の増加を販売数量の増加で吸収しきれず1億16百万円（前年同期比357.3%）の営業損失となりました。

2.　連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期末の総資産合計は、前連結会計年度末比13億9百万円増の385億57百万円となりました。主な内訳としては、現金及び預金10億56百万円、受取手形及び売掛金5億26百万円、投資有価証券2億81百万円がそれぞれ増加し、また有形固定資産が1億52百万円減少しております。

負債合計は、前連結会計年度末比13億95百万円増の287億63百万円となりました。主な内訳としては、支払手形及び買掛金3億38百万円、リース債務14億71百万円がそれぞれ増加しております。

純資産合計は、前連結会計年度末比85百万円減の97億93百万円となりました。主な内訳としては、その他有価証券評価差額金1億67百万円が増加し、また利益剰余金が3億4百万円減少しております。

3.　連結業績予想に関する定性的情報

平成21年3月期の連結業績予想につきましては、平成20年5月13日に発表いたしました業績予想を変更いたしておりません。

なお、業績予想につきましては、現時点で把握可能な情報に基づき、合理的と判断した前提により作成しておりますが、多様なリスクや不確定な要因を含んでおり、実際の業績等は、記載の内容と異なる可能性があることをあらかじめご承知おきください。

4.　その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①棚卸資産の評価方法

当第1四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地高卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。
また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。
なお、法人税等調整額は「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成19年3月14日　企業会計基準第12号) 及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会　平成19年3月14日　企業会計基準適用指針第14号) を当第1四半期連結会計期間から適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっていたが、当第1四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号　平成18年7月5日) が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法 (貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法) により算定しております。
これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ103百万円増加しております。

③リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 (平成5年6月17日 (企業会計審議会第一部会)、平成19年3月30日改正)) 及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号 (平成6年1月18日 (日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年3月30日改正)) が平成20年4月1日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第1四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

④連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会　平成18年5月17日　実務対応報告第18号) を当第1四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。
なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	当第１四半期連結会計期間末 (平成20年6月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成20年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,207	2,151
受取手形及び売掛金	10,966	10,440
商品	1,665	1,738
製品	2,624	3,078
原材料	1,995	1,438
仕掛品	4,151	3,995
貯蔵品	54	54
繰延税金資産	119	119
その他	563	1,200
貸倒引当金	△5	△6
流動資産合計	25,343	24,210
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	3,879	3,940
機械装置及び運搬具	1,891	3,527
リース資産	1,469	－
土地	1,310	1,310
建設仮勘定	160	60
その他	313	338
有形固定資産合計	9,024	9,177
無形固定資産	66	68
投資その他の資産		
投資有価証券	1,913	1,632
長期前払費用	112	113
繰延税金資産	1,739	1,676
その他	315	323
貸倒引当金	△22	△24
投資その他の資産合計	4,058	3,721
固定資産合計	13,149	12,967
繰延資産	64	69
資産合計	38,557	37,247

(単位：百万円)

	当第１四半期連結会計期間末 (平成20年6月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成20年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	9,210	8,872
短期借入金	3,955	4,176
1年内償還予定の社債	500	500
リース債務	215	－
未払金	220	137
未払費用	416	477
未払法人税等	13	15
賞与引当金	147	275
その他	221	76
流動負債合計	14,900	14,531
固定負債		
社債	8,200	8,200
長期借入金	3,040	3,300
リース債務	1,256	－
退職給付引当金	1,115	1,179
その他	250	158
固定負債合計	13,863	12,837
負債合計	28,763	27,368
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,041	4,041
資本剰余金	4,077	4,077
利益剰余金	2,301	2,606
自己株式	△509	△509
株主資本合計	9,912	10,216
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	204	37
為替換算調整勘定	△323	△375
評価・換算差額等合計	△118	△337
純資産合計	9,793	9,879
負債純資産合計	38,557	37,247

(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円）

	当第１四半期連結累計期間 （自 平成20年4月 1日 至 平成20年6月30日）
売上高	
製品売上高	4,791
商品売上高	4,514
売上高合計	9,305
売上原価	
製品売上原価	4,325
商品売上原価	4,094
売上原価合計	8,419
売上総利益	885
販売費及び一般管理費	1,290
営業損失（△）	△404
営業外収益	
受取利息	0
受取配当金	18
為替差益	80
物品売却益	26
雑収入	15
営業外収益合計	142
営業外費用	
支払利息	74
長期前払費用償却	33
社債発行費償却	5
コミットメントフィー	4
たな卸資産廃棄損	1
雑支出	26
営業外費用合計	145
経常損失（△）	△407
特別利益	
貸倒引当金戻入額	2
特別利益合計	2
特別損失	
固定資産除却損	7
特別損失合計	7
税金等調整前四半期純損失（△）	△412
法人税、住民税及び事業税	△169
四半期純損失（△）	△242

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

	当第１四半期連結累計期間 （自　平成20年4月1日 至　平成20年6月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前四半期純損失（△）	△412
減価償却費	389
繰延資産償却額	44
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△77
受取利息及び受取配当金	△19
支払利息	74
為替差損益（△は益）	24
有形固定資産除却損	7
売上債権の増減額（△は増加）	△415
たな卸資産の増減額（△は増加）	△124
仕入債務の増減額（△は減少）	204
未払費用の増減額（△は減少）	△97
賞与引当金の増減額（△は減少）	△128
その他	871
小計	339
利息及び配当金の受取額	19
利息の支払額	△41
法人税等の支払額	△12
営業活動によるキャッシュ・フロー	305
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△178
貸付けによる支出	△1
貸付金の回収による収入	1
その他	△7
投資活動によるキャッシュ・フロー	△186
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	3,876
短期借入金の返済による支出	△4,338
長期借入金の返済による支出	△60
セール・アンド・リースバックによる収入	1,483
配当金の支払額	△45
その他	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	915
現金及び現金同等物に係る換算差額	21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,056
現金及び現金同等物の期首残高	2,051
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,107

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント】

当連結グループは、電子部品の製造・販売及び開発を主たる事業として行っており、その製品は情報通信機器、自動車電装品、事務機器及び工作機械等に幅広く応用されています。

しかし、販売市場は多岐にわたるうえ、各市場で使用する製品は互いに類似、重複しておりますので、それぞれ分離独立した事業区分としての経営活動は行っておりません。また、製品の種類・性質及び製造方法から見ても単一の事業区分と認識するほうが経営の実態を適切に反映できるものと考え、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

当第1四半期連結累計期間（自　平成20年4月1日　至　平成20年6月30日）

	日　本 （百万円）	アジア （百万円）	計 （百万円）	消去又は全社 （百万円）	連　結 （百万円）
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	7,307	1,997	9,305	—	9,305
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	246	128	374	(374)	—
計	7,553	2,125	9,679	(374)	9,305
営　業　利　益	(275)	(116)	(392)	(12)	(404)

（注）1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

アジア：台湾、フィリピン、シンガポール、中国

【海外売上高】

当第1四半期連結累計期間（自　平成20年4月1日　至　平成20年6月30日）

	アジア（百万円）	北米（百万円）	ヨーロッパ（百万円）	計（百万円）
Ⅰ　海外売上高	2,716	29	19	2,764
Ⅱ　連結売上高				9,305
Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合(%)	29.2%	0.3%	0.2%	29.7%

（注）1.国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2.本邦以外の区分に属する主な国又は地域

アジア　　：中国、韓国、シンガポール、台湾

北米　　：米国、カナダ

ヨーロッパ：フィンランド、スイス、アイスランド

3.海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

「参考資料」

(要約)前四半期連結損益計算書　　(単位：百万円)

科　　目	前第１四半期連結累計期間 (自　平成19年4月 1日 至　平成19年6月30日)
	金　額
Ⅰ　売上高	9,103
製品売上高	5,241
商品売上高	3,861
Ⅱ　売上原価	7,577
製品売上原価	4,163
商品売上原価	3,413
売上総利益	1,525
製品売上利益	1,077
商品売上利益	448
Ⅲ　販売費及び一般管理費	1,211
営業利益	313
Ⅳ　営業外収益	68
Ⅴ　営業外費用	160
経常利益	221
Ⅵ　特別利益	―
Ⅶ　特別損失	1
税金等調整前四半期純利益	219
法人税、住民税及び事業税	98
四半期純利益	121

「参考資料」

(要約)前四半期連結キャッシュ・フロー計算書　　(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自　平成19年4月 1日 至　平成19年6月30日)
区　　分	金　額
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前四半期純利益	219
減価償却費	311
売上債権の増減額(増加：△)	409
たな卸資産の増加額(△)	△ 1,052
仕入債務の増加額	122
その他の増減額	342
法人税等の支払額	△ 33
営業活動によるキャッシュ・フロー	320
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 1,324
投資有価証券の取得による支出	△ 12
その他の増減額	5
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,330
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の純増減額	809
長期借入金による収入	―
長期借入金の返済による支出	△ 65
社債発行による収入	―
配当金の支払額	△ 94
その他の増減額	2
財務活動によるキャッシュ・フロー	652
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 7
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)	△ 366
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	2,317
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	1,950

6.その他の情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

区分	生産高（百万円）
半導体素子製品	2,739
半導体応用製品	1,632
合計	4,371

（注）1.金額は、販売価格によっております。
2.上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。
3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 商品仕入実績

区分	仕入高（百万円）
オプト	1,429
IC	965
ユニット	610
発振子	385
その他	636
合計	4,028

（注）1.金額は、仕入価額によっております。
2.上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。
3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 受注実績

区分	受注高（百万円）	受注残高（百万円）
半導体素子製品	3,290	1,160
半導体応用製品	2,009	1,613
製品計	5,299	2,774
商品計	3,679	1,900
合計	8,978	4,674

（注）1.上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。
2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(4) 販売実績

区分	販売高（百万円）
半導体素子製品	3,260
半導体応用製品	1,531
製品計	4,791
商品計	4,514
合計	9,305

（注）1. 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。